



中华人民共和国国家标准

GB/T 15652—1995

金属氧化物半导体气敏元件总规范

Generic specification for gas sensors of metal-oxide semiconductor

1995-07-24 发布

1996-04-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 总则	(1)
2.1 优先顺序	(1)
2.2 有关文件	(1)
2.3 术语、符号、代号	(1)
2.4 分类	(2)
2.5 标志	(2)
3 质量评定程序	(2)
3.1 质量评定体系	(2)
3.2 初始制造阶段	(2)
3.3 结构相似的元件	(2)
3.4 鉴定批准程序	(2)
3.5 质量一致性检验	(4)
4 试验和测量方法	(5)
4.1 试验程序	(5)
4.2 标准大气条件	(5)
4.3 试验顺序	(5)
4.4 直观检查和尺寸检查及其方法	(5)
4.5 电气参数测量及其方法	(6)
4.6 环境试验及其方法	(6)
4.6.1 振动(正弦)	(6)
4.6.2 冲击(规定脉冲)	(6)
4.6.3 跌落	(7)
4.6.4 引出端强度	(7)
4.6.5 锡焊	(8)
4.6.6 温度冲击	(8)
4.6.7 交变湿热	(9)
4.6.8 低温	(9)
4.6.9 高温	(10)
4.6.10 耐腐蚀	(10)
4.7 电负荷试验及其方法	(11)
4.7.1 短期负荷	(11)
4.7.2 长期负荷	(11)
4.8 其他试验及其方法	(12)
4.8.1 老化	(12)
4.8.2 防爆	(12)

中华人民共和国国家标准

GB/T 15652—1995

金属氧化物半导体气敏元件总规范

Generic specification for gas sensors of metal-oxide semiconductor

1 主题内容与适用范围

本规范规定了金属氧化物半导体气敏元件(以下简称气敏元件)质量评定程序、试验和测量方法、包装和储运的一般要求。具体要求和特性在相应的空白详细规范和详细规范中规定。

本规范适用于金属氧化物半导体气敏元件,其他气敏元件亦可参照采用。

2 总则

2.1 优先顺序

若本规范要求与详细规范或其他有关文件之间出现矛盾,应按如下优先顺序使用文件:

- a. 详细规范;
- b. 空白详细规范;
- c. 总规范;
- d. 中国电子元器件质量认证章程;
- e. IECQ QC001002《IEC 电子元器件质量评定体系 程序规则》;
- f. 其他引用文件(如 IEC 文件)。

2.2 有关文件

GB 191 包装储运图示标志

GB 2421 电工电子产品基本环境试验规程 总则

GB 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A:低温试验方法

GB 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B:高温试验方法

GB 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db:交变湿热试验方法

GB 2423.5 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ea:冲击试验方法

GB 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Fc:振动(正弦)试验方法

GB 2423.20 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Kd:接触点和连接件的二氧化硫试验方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 4475 敏感元器件术语

GB 7408 星期编号

GB/T 15653 金属氧化物半导体气敏元件测试方法

SJ 1155 敏感元器件型号命名方法

SJ/T 10554 敏感元器件 文字符号

SJ/T 10555 电气用图形符号 敏感元器件

IECQ QC001002 IEC 电子元器件质量评定体系 程序规则

2.3 术语、符号、代号

国家技术监督局 1995-07-24 批准

1996-04-01 实施